

国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟

IC 封联（2015 ） 18 号

邀 请 函

封测联盟各单位及业界同仁：

中国半导体产业经过 60 年的发展，目前已形成设计、芯片制造、封装测试三个完整产业链。近年来，中国封测业成长尤为迅速，封测企业迅速崛起，销售额占据半导体产业的半壁江山。

2012 年 9 月，在国家相关部门、集成电路产业界、学术界的大力支持下，华进半导体封装先导研发中心由中科院微电子所和集成电路封测产业龙头企业长电科技、通富微电、华天科技、深南电路、苏州晶方、安捷利（苏州）、中科物联、兴森快捷 9 家单位共同投资而建立，并将其设立为国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟的系统集成先导技术研发平台，通过以企业为主体的产学研用结合新模式，开展系统级封装/集成先导技术研究。

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司现作为国家封测联盟共性技术研发中心及江苏省产业技术研究院半导体封装技术研究所，正向着国际一流的封装与系统集成先导技术研发与产业化中心迈进。为了同业界

共享成长喜悦，促进与业界的合作与交流，提高我国封测企业在国际市场的竞争力，华进半导体将于 2015 年 12 月 9 日举办华进开放日活动。

此次活动在国家科技重大专项（02）专项总体组、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟、江苏省产业技术研究院的指导下，联合集成电路材料产业技术创新战略联盟和 SEMI 共同举办，通过专题讲座的形式进行电子封装领域的前沿技术交流。

诚邀各单位领导及专家莅临指导！

时间：2015 年 12 月 9 日（星期三）8:45-17:30

地点：无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D1 栋 6 楼（华进半导体封装先导技术研发中心有限公司）

参会回执请于 2015 年 11 月 30 日（星期一）前反馈到 caixiazhang@ncap-cn.com 邮箱。

附件一：活动议程

附件二：参会回执

国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟

2015 年 11 月 20 日



会议联系人： 张琼月 张彩霞 caixiazhang@ncap-cn.com

15190266369 0510-66679352

附件一：

活动议程

◇ 时间：2015 年 12 月 9 日（星期三）8:45-17:30

◇ 地点：江苏省无锡市菱湖大道 200 号 D1 栋 6F

◇ 指导单位：国家科技重大专项（02）专项总体组、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟、江苏省产业技术研究院

◇ 主办单位：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

◇ 联合单位：集成电路材料产业技术创新战略联盟、SEMI

会议时间	会议内容	演讲者
上午议程，会议主持：林挺宇		
8:45-9:15	会议签到（6F）	
9:15-9:35	欢迎辞及企业介绍	曹立强 华进半导体 总经理
9:35-9:40	国家科技重大专项（02）专项总体组领导致辞	叶甜春
9:40-9:45	江苏省产业技术研究院领导致辞	胡义东
9:45-9:50	无锡市领导致辞	
9:50-9:55	无锡新区领导致辞	
9:55-10:00	国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟领导致辞	于燮康
10:00-10:05	江苏省产业技术研究院半导体封装技术研究所揭牌仪式	
10:05-10:15	华进封装材料应用验证平台揭牌仪式	
10:15-10:30	茶歇	
10:30-11:30	Trends in Advanced Packaging（电话演讲）	Jan Vardaman TECH SEARCH
11:30-12:30	FanouteWLB and 2.5D/3D Cost Modeling（电话演讲）	Amy PaleskoSavansys

12:30-13:30	午餐（日全食）	
下午议程，会议主持：张文奇		
13:30-13:50	中国半导体产业概览	Jesse Zhang SEMI
13:50-14:50	封装工艺主题演讲	
13:50-14:10	JCAP Group Overview	梁新夫 长电科技
14:10-14:30	TBD	林仲珉 通富微电
14:30-14:50	The Development of 3D WLCSP at Huatian Group	于大全 华天科技
14:50-16:10	半导体装备主题演讲	
14:50-15:10	激光应用在先进封装中的应用	徐海宾 德龙激光
15:10-15:30	NMC 在先进封装领域的产品拓展及发展策略	北方微
15:30-15:50	Continuous Improvement of TSV Etch	钟鑫生 中微
15:50-16:10	Fineplacer® Sigma 亚微米倒装贴片机简介	刘云兵 FINETECH
16:10-16:25	茶歇	
16:25-17:25	半导体材料主题演讲	
16:25-16:45	封装对基板的要求及封装基板的技术发展趋势	孔令文 深南电路
16:45-17:05	电子材料研发与产业化国际合作模式的反思	陈田安 德邦
17:05-17:25	有机硅技术在半导体封装应用的革新	Andrew Ho 道康宁

（说明：本议程为初步安排，以会议当日安排为准）

附件二：

参会回执

单位名称			
参会人员情况			
姓名	职务	手机/其他联系方式	12月8日晚住宿安排(费用自付)
			☐ 否 ☐ 铂尔曼 ☐ 协信维嘉 ☐ 格林豪泰
			☐ 否 ☐ 铂尔曼 ☐ 协信维嘉 ☐ 格林豪泰
			☐ 否 ☐ 铂尔曼 ☐ 协信维嘉 ☐ 格林豪泰
			☐ 否 ☐ 铂尔曼 ☐ 协信维嘉 ☐ 格林豪泰

备注：

1. 住宿协议价：铂尔曼 400 元/晚；协信维嘉 268 元/晚；格林豪泰 168 元/晚；如需预定，请在上表中勾选，入住时报“华进半导体”或者“预订人姓名”；

2. 参会信息请于 2015 年 11 月 30 日（星期一）前反馈；

3. 联系人/电话：张晓芸 xiaoyunzhang@ncap-cn.com 13921535040 0510-66679336
张彩霞 caixiazhang@ncap-cn.com 15190266369 0510-66679352

国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟秘书处

二〇一五年十一月二十日